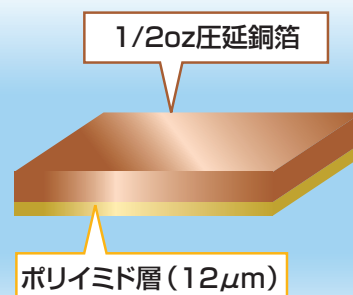


# 信越片面銅張積層板 オールポリイミドの“K-Pシリーズ”

信越化学工業では、屈曲特性に優れた日鉱金属(株)製のHA箔を使用した、オールポリイミド片面銅張積層板を開発致しました。

ベースフィルムに10μmのポリイミドフィルムを使用し、高温から低温まで、非常に優れた屈曲性を実現しました。



## 一般特性

項目		単位	高屈曲タイプ		従来タイプ	試験法・条件等	
品番			KN12SR18P	KE12SR18P	KN12SR18A		
構成	ベースPIフィルム		Apical NPI	Kapton EN	Apical NPI		
	ベースPI厚み	μm	10	10	10		
	高耐熱PI接着層	μm	2	2	2		
	銅箔(圧延)	oz	1/2	1/2	1/2		
	銅箔タイプ		HA箔	HA箔	一般箔		
製品厚さ		μm	30	30	30		
180°剥離強度		N/cm	5.3	6.9	5.0	JIS C6471	
半田耐熱性	常態	℃	360<	360<	360<	JIS C6471 30秒間浸漬	
寸法安定性	エッチング後	MD	%	±0.00	+0.01	-0.01	IPC FC241
		TD	%	+0.07	+0.06	+0.07	
	加熱処理後	MD	%	-0.04	-0.03	-0.03	
		TD	%	+0.06	+0.05	+0.07	
MIT耐折性 (R=0.8mm, T=250gf)	MD	回	>10000	>10000	2760	JIS C6471	
	TD	回	>10000	>10000	2930		
MIT耐折性 (R=0.38mm, T=250gf)	MD	回	2000	1640	605	JIS C6471	
	TD	回	2070	1425	685		
線間絶縁抵抗	常態	Ω	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	IPC FC241	
線膨張係数(23-200℃)		ppm/℃	8.2	22.7	8.2	ASTM D696	
耐溶剤性	MEK		変色、膨れ、はがれ等なし	変色、膨れ、はがれ等なし	変色、膨れ、はがれ等なし	JIS C6481 室温15分浸漬	
	トルエン						
	IPA						
接着層 ガラス転移温度(Tg)		℃	370	370	370	DMA法	
ハロゲン含有率	Cl	ppm	N.D.	N.D.	N.D.	JPCA-ES-01-2003	
	Br	ppm	N.D.	N.D.	N.D.		
難燃性			V-0相当	V-0相当	V-0相当	UL94	

\*本表のデータは、代表値であって保証値ではありません。